高熱伝導グラファイトのパワー半導体モジュール放熱板への適用可能性

山田　靖 *，柳瀬　匡史 *，三浦　大貴 *，竹馬　克洋 **

A Study of Novel Heatsink for Power Semiconductor Modules Using High Thermal Conductive Graphite

Yasushi YAMADA*, Masashi YANASE*, Daiki MIURA* and Katsuhiro CHIKUBA**

* 大同大学（〒 457-8530　愛知県名古屋市南区滝春町 10 番地 3）
** 株式会社サーモグラフィティクス（〒 551-0031　大阪府大阪市大正区泉尾 6-2-29　テクノシーズ泉尾 405 号）
* Daido University (10-3 Takiharu-cho, Minami-ku, Nagoya-city, Aichi 457-8530)
** Thermo Graphitics Co., Ltd (TechnoSeeds Izuo 405, 6-2-29 Izuo, Taisho-ku, Osaka-city, Osaka 551-0031)